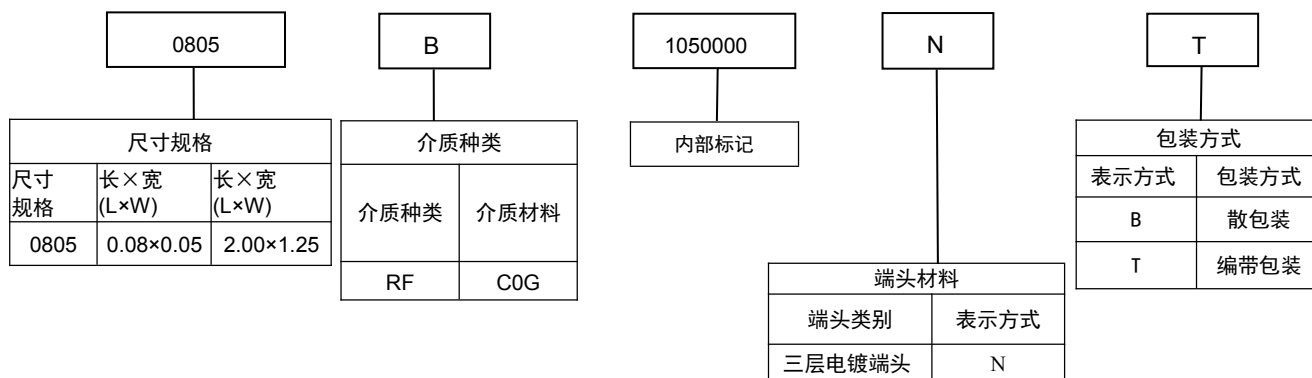
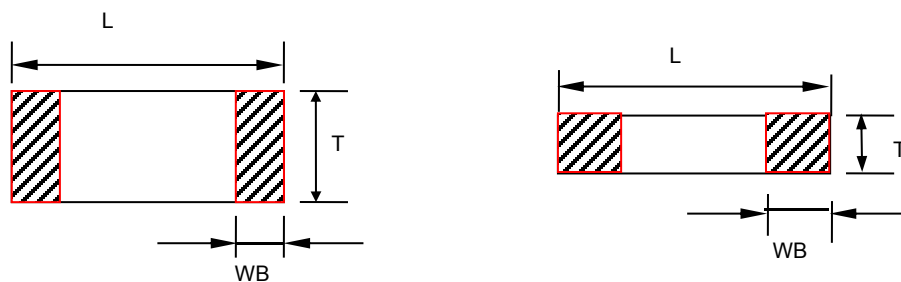


■ 陶瓷结构件

◆ 特征

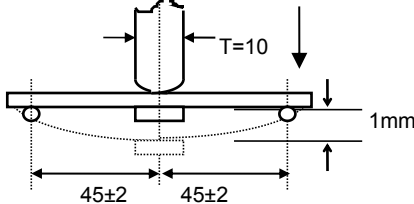
- * 本陶瓷结构件有高绝缘性、耐高温性、高强度等性能；
- * 优异的耐焊锡性及高附着强度
- * 适合回流焊和波峰焊接



◆ 型号表示法

◆ 产品尺寸


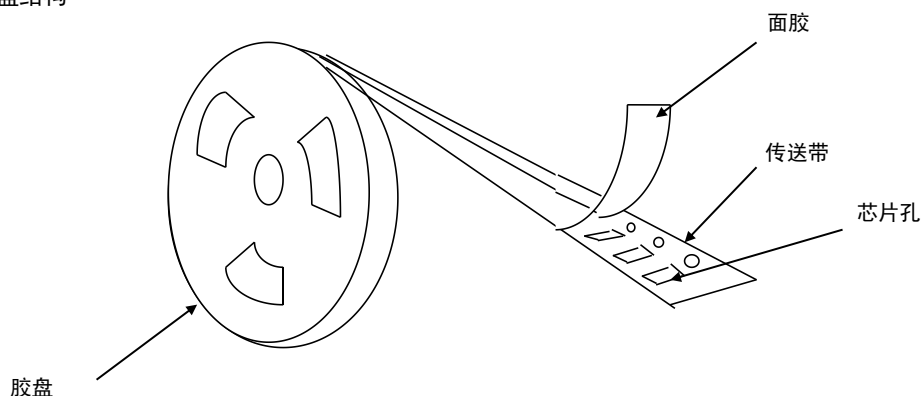
型号		尺寸 (mm)			
英制表示	公制表示	L	W	T	WB
0805	2012	2.00±0.2	1.25±0.2	1.0±0.05	0.4±0.10

◆ 可靠性测试

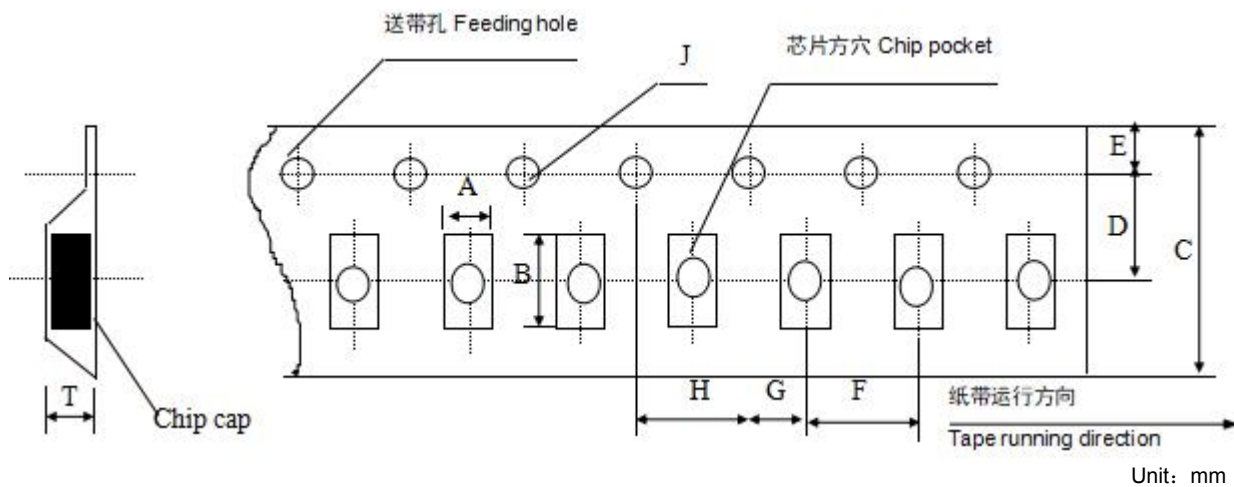
项目	技术规格	测试方法	
可焊性	上锡率应大于 95% 外观：无可见损伤.	将电容在 80~120℃ 的温度下预热 10~30 秒.	
		有铅焊料：(Sn/Pb: 63/37) 浸锡温度: 235±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s	无铅焊料: 浸锡温度: 245±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s
抗弯曲强度	外观：无可见损伤.	试验基板：PCB 弯曲深度：1mm 施压速度：0.5mm/sec. 单位：mm 应在弯曲状态下进行测量。 	
端头结合强度	外观无可见损伤	施加的力：5N	时间：10±1S
瓷体强度	外观无可见损伤	施加的力：20N	时间：10±1S

◆ 包装

* 塑胶卷盘结构



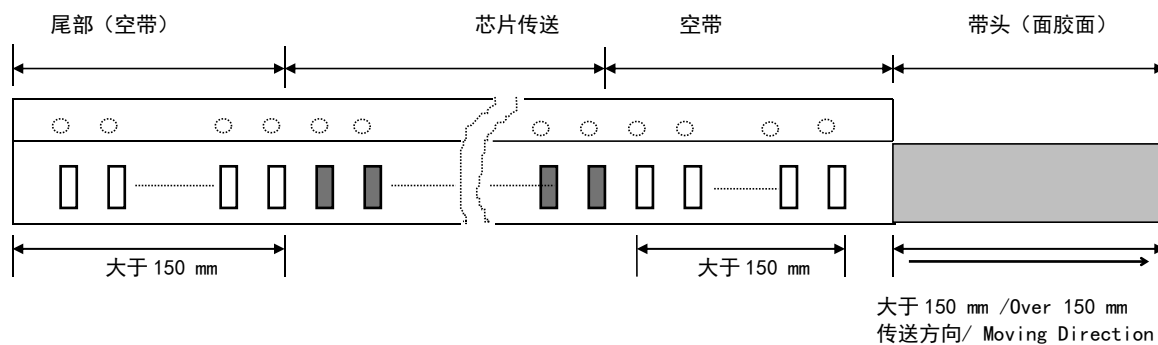
* 塑胶带尺寸结构



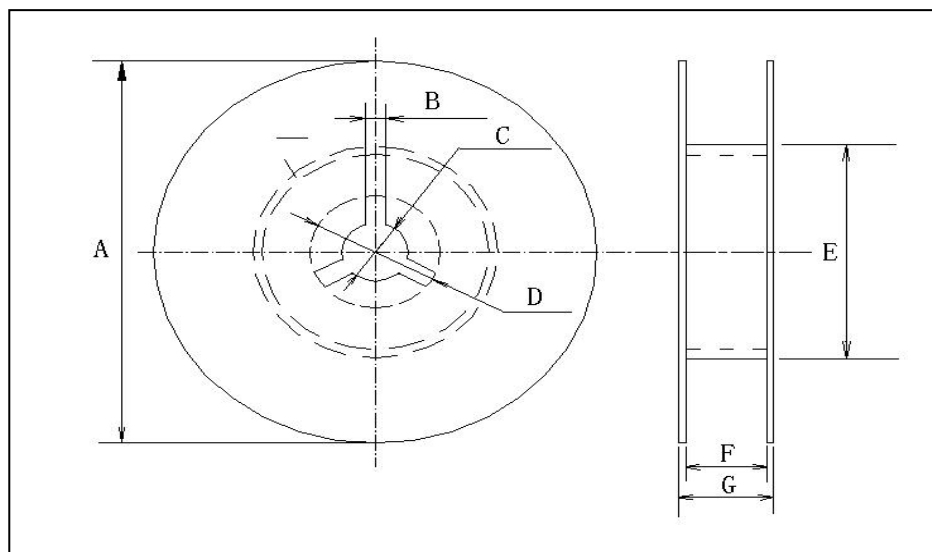
代号 纸带规格	A	B	C	D*	E	F	G*	H	J	T
0805	1.55 ±0.20	2.35 ±0.20	8.00 ±0.20	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	1.50 Max

备注：*表示此处对尺寸的要求非常精确。

* 传送带的前后结构



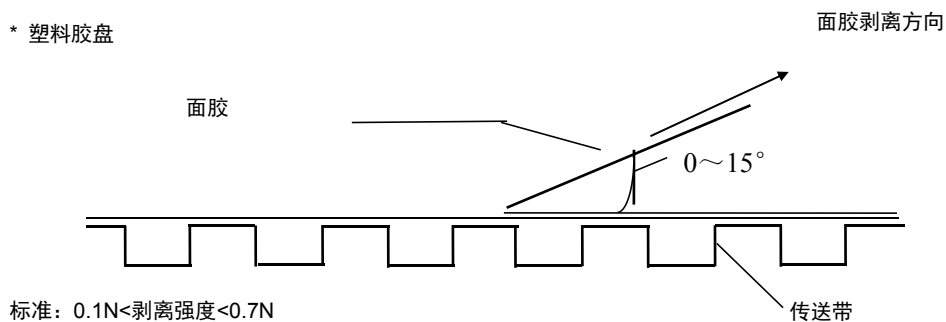
* 卷盘尺寸



卷盘型号	A	B	C	D	E	F	G
7"REEL	φ178±2.0	3.0	φ13±0.5	φ21±0.8	φ50 或更大 φ50 or more	10.0±1.5	12max

* 关于卷带的说明：面胶剥离强度

* 塑料胶盘



* 包装数量

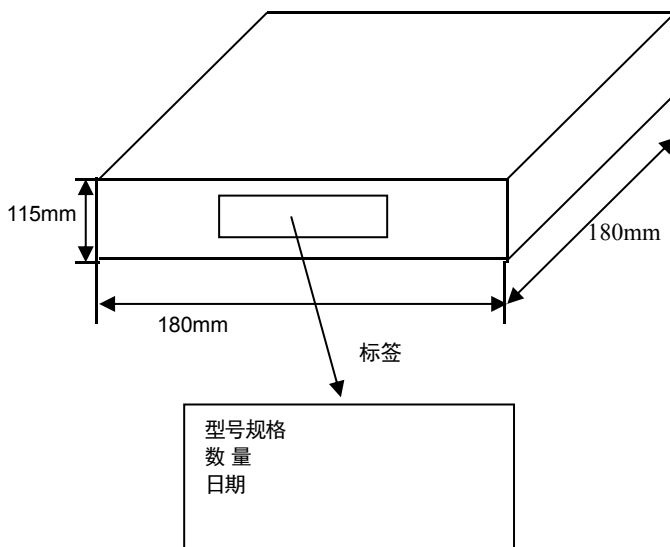
尺寸	包装形式和数量 unit: pcs		
	胶带卷盘	塑料盒散装	一般散装
0805	3000	10000	5000

注意：包装的形式和数量可根据客户的要求来定。

*外包装

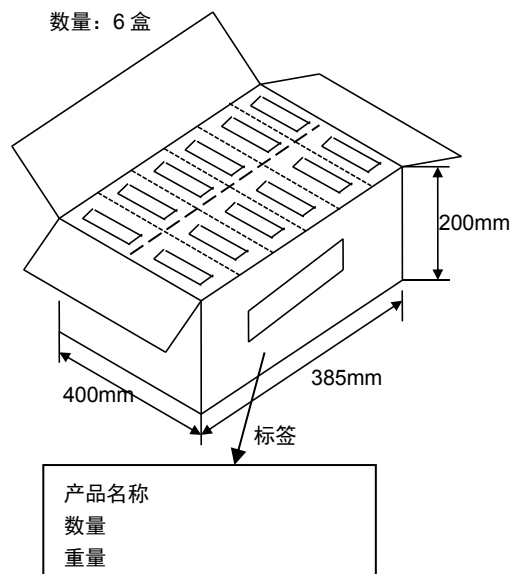
小包装

数量：10 卷



大包装

数量：6 盒



*◆储存方法

* 确保芯片可焊性良好的贮存期限为 12 个月(在包装好已交付的情况下)。

* 储存条件：

储存温度： 5~40℃

储存相对湿度： 20~70%

◆使用前的注意事项

多层片式瓷介电容器 (MLCC) 在短路或开路的电路中都有可能失效, 在超出本承认书或相关说明书中所述使用频率的恶劣工作环境, 或外界机械力超压作用下, 电容芯片都有可能着火、燃烧甚至爆炸, 所以在使用的时候, 首先应考虑按本承认书的有关说明来进行, 如有不明之处, 请联系我们技术部、品管部或生产部。

*** 焊接的条件与相关图表**

为避免因温度的突然变化而引起的芯片开裂或局部爆炸的现象发生, 请按有关温度曲线图表来进行。(请参考附页中的图表)

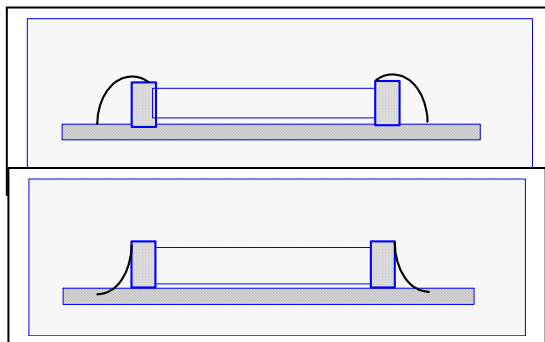
*** 手工焊接**

手工焊接很容易因为芯片局部受热不均而引起瓷体微裂或局部爆炸的现象, 在焊接时, 如果操作者不小心, 会使烙铁头直接同电容芯片的瓷体部分接触, 这样很容易使电容芯片因热冲击而受损或出现其他意外, 因此, 使用电烙铁手工焊接时应仔细操作, 并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心。

*** 适量的焊料**

焊料过多

焊料太少

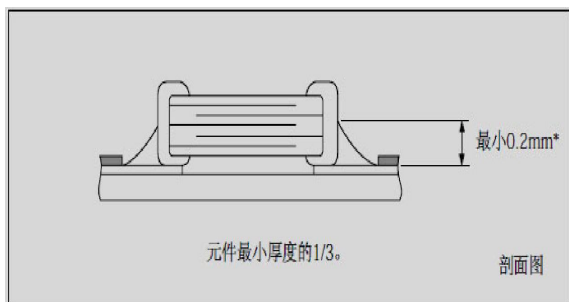


这样会因端头压力过大而可能引起芯片受损

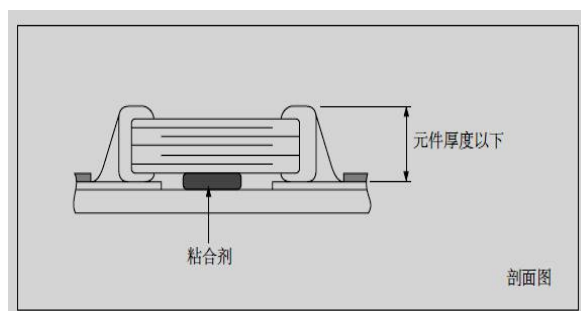
固定力量不足, 可能会引起电容芯片与线路接触不良

*** 推荐焊料用量**

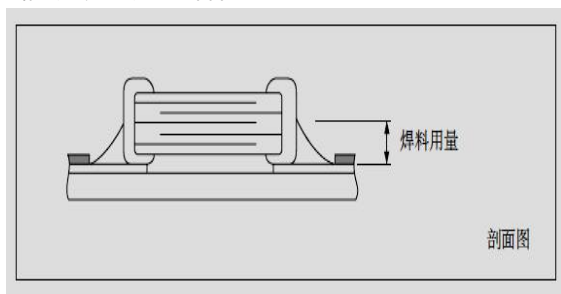
回流焊接的最佳焊料用量



波峰焊接的最佳焊料用量



使用烙铁返修时的最佳焊料量



*** 推荐焊接方式**

规格尺寸	温度特性	额定电压	容量范围	焊接方式
0805	C0G/X7R	/	/	R/W

焊接方式: R—回流焊

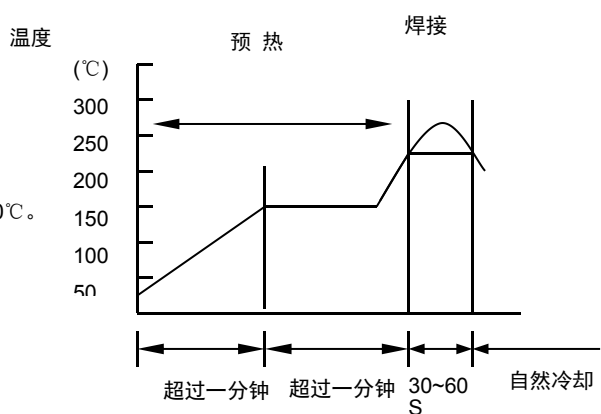
W—波峰焊

◆ 推荐焊接温度曲线图

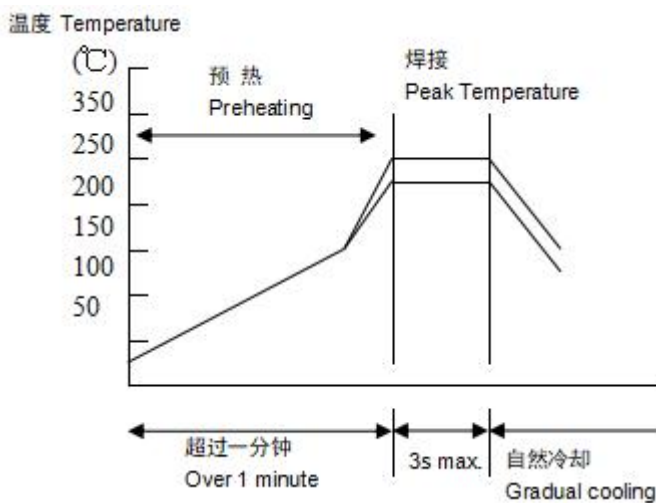
* 回流焊接

	Pb-Sn 焊接	无铅焊接
尖峰温度	230℃~250℃	240℃~260℃

在预热时，请将焊接温度与芯片表面温度之间的温差维持在 $T \leq 150^\circ\text{C}$ 。



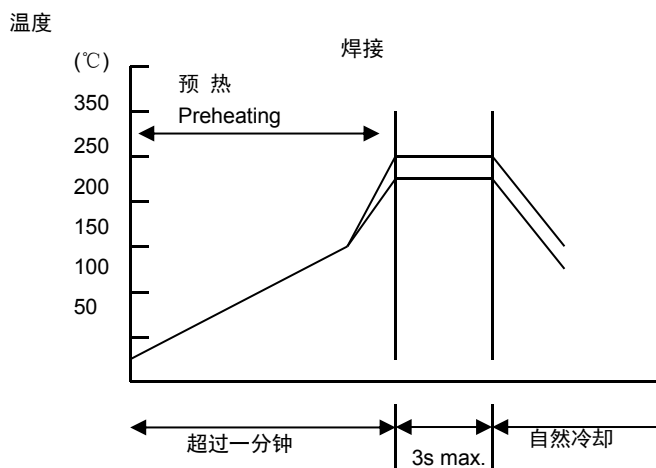
* 波峰焊接



	Pb-Sn 焊接	无铅焊接
尖峰温度	230℃~260℃	240℃~270℃

在预热时，请将焊接温度与芯片表面温度之间的温差维持在 $T \leq 150^\circ\text{C}$ 。

* 手工焊接



条件:

预热	烙铁头温度	烙铁功率	烙铁头直径	焊接时间	锡膏量	限制条件
$\Delta \leq 130^\circ\text{C}$	最高 350°C	最大 20W	建议 1mm	最长 3s	$\leq 1/2$ 芯片厚度	请勿使用烙铁头直接接触陶瓷元件

*以最新版本的内容为准